珠海全志科技股份有限公司

证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2026-0327-003

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以825,427,382股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全志科技	股票代码	300458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡宵鹏	王艺霖	
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号	
传真	0756-3818300	0756-3818300	
电话	0756-3818276	0756-3818276	
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品满足工业、车载、消费领域的应用需求,产品广泛适用于智能硬件、智能机器人、智能家电、智能物联网、智能汽车电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等多个产品市场。

(二)主要经营模式

采购及生产模式,公司采用Fabless模式,负责集成电路的设计,而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆,向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

销售模式,经由测试合格的芯片交给公司后,公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品,经过二次开发后再销售给整机厂商,整机厂商生产各类终端电子产品。

研发模式,公司坚持自主研发关键核心技术,择优整合行业成熟IP资源,及时为目标市场客户提供有特色竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时,进行下一代产品的技术储备。

(三)经营情况

1.主要芯片产品的类别

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的定义,公司所处行业属于“C制造业-)39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业-)652集成电路设计”。根据《国家重点支持的高新技术领域》的定义,公司所处的技术领域属于“一、电子信息-)(二)微电子信息-)2集成电路产品设计技术”。

2.国内外主要同行业公司

国内外主要同行业公司:联发科、晶晨股份、瑞芯微、星宸科技等。

3.主要芯片产品包的基础架构

公司一直致力于为客户提供系统级的SoC产品包,为了提高研发交付能力和加快产品迭代速度,坚持不断建设和完善各种技术平台和产品平台,通过多年积累打造了4个平台:

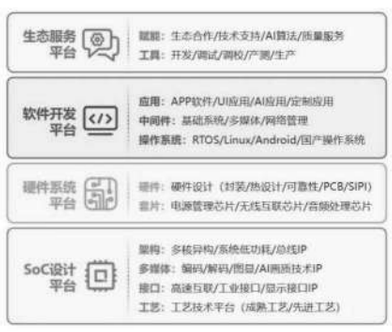
(1)SoC设计平台:包括工艺技术平台(成熟工艺、先进工艺),数模混合IP、编解码及显示IP技术、SoC多核异构及总线,系统低功耗等技术。

(2)硬件系统平台:形成了SoC配套系列芯片,包括电源管理芯片、无线互联芯片、音频处理芯片,以及完整的硬件系统设计,包括信号和电源完整性、热设计、可制造性设计的板级设计技术。

(3)软件开发平台:提供RTOS/Linux/Android等多种操作系统平台的完整支持,以及国产主流操作系统的生态适配;同时结合产品应用,形成了相应的中间件、应用软件交付。

(4)生态服务平台:针对服务赋能,提供了技术支持服务、开放合作生态和质量体系服务等支撑功能,同时针对下游客户输出了高效的工具链支撑。

整个SoC产品包的基础架构示意图如下:



4.公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例

产品大类	产品系列	主要型号产品	主要应用领域	应用示例
智能终端应用处理器芯片	A系列	A33、A100、A133、A133P、A333、A523、A527、A537、A733	平板电脑、教育平板、安卓笔电、电子相册、支付设备、游戏机、电子书等	平板电脑:Aura、Multilazer、Acer、Whitedeer、Blackview等; 智能教育:台电教育平板、小霸王教育平板、作业帮AI智能辅导机、希沃随身听力机、百词斩英语扫学机等,希沃教育平板、希沃学习机、移动云智慧教育平板、贝乐生教育平板; 智慧零售:一破收银设备、ELC 安卓AI智能随心屏+; 其它智能硬件:沃特沃德智能AI随行屏、瑞莎单板计算机;
	F系列	F1C100S、F1C200S、F133、F135	多媒体播放器、车载仪表、人机交互HMI、视频机等	汽车电子:JVC&Kenwood后装车机、盯盯拍车载智慧屏、爱码电动车仪表、小牛两轮车仪表盘; 人机交互模块(HMI):贝斯特电梯面板HMI、富士康产检设备HMI、公牛智能开关面板、芯烁热敏标签打印机、Insta360 GO3拇指相机;
	H系列	H135、H313、H616、H618、H700、H713、H716、H723、H727	智能机顶盒、智能投影、商业显示、云解码、开源开发板、多屏互动等	智能机顶盒:腾讯-创维极光、天猫魔盒、longTV等智能机顶盒; 智能投影:创维、飞利浦、微米、优派等智能投影; 智能办公:绿联办公投屏、创维小湃拍拍4K高清投屏器等; 开源开发板:Orangepi、Nanopi等;
	R系列	R16、R128、R328、R329、R818、MR133、MR153、MR813、MR527、MR536	智能音箱、智能家电、扫地机器人、3D打印机、AI玩具、词典笔等	扫地机器人:石头、云鲸、小米、追觅、美的、海尔等品牌; 割草机器人:九号、乐动等品牌; 智能家电:美的、海尔、小米等品牌的家电智能模块; 智能音箱:天猫精灵、小米、小度等品牌; 智能家居:小米、绿米、欧瑞博等家居智能控制面板; 智能办公:创想三维3D打印机、小米喷墨打印机等; 智能教育:辞海词典笔、优学派词典笔、作业帮词典笔、作业帮智能作业桌等; 机器人:小米CyberDog 仿生机器人、汤姆猫AI语音情感陪伴机器人等;
	T系列	T3、T5、T7、T113、T153、T527、T536	智能座舱、辅助驾驶、智慧工业、行业智能、智能电网等	汽车电子:吉利领克全景系统、红旗全景系统、五菱中控车机、润光智行舱开一体方案等; 电力设备:南瑞继保电力二次保护设备、国网电力集中器/能源控制器、南网电力网关、威思顿集中器等; 智能工业:汇川工业HMI、汇川工业PLC、西门子工业HMI、昆仑通态工业HMI、三旺工业网关等; 工业开发板:米尔、创龙、飞凌等工业开发板;
	TV系列	TV303	智能电视、商业显示	视源电视板卡;
	V系列	V3、V316、V526、V533、V536、V553、V821、V851S、V853、V861、V881	网络摄像头、安防摄像机、低功耗电池门铃、多目枪球摄像头、智能门锁、智能猫眼、行车记录仪、运动相机、扫描笔/词典笔、AI智能硬件等	IPC:创维小湃、普维、EKEN等IPC; 汽车电子:PAPAGO智能行车记录仪、捷渡车载智慧屏、共享电单车AI识别摄像头等; 智能门禁:EKEN低功耗门铃,得力智能考勤机、移康智能门锁、凯迪仕智能门锁、德施曼智能门锁等; 智能教育:暗宝智能学习打印机、噜咔博士AI拍字机、芯烁错题打印机等; 智能相机:汉印相立得; AI眼镜:青橙AI眼镜、魔力宝AI眼镜;

(一)行业发展阶段

1.人工智能技术的快速发展

人工智能,一般而言是对人的意识和思维过程的模拟,但随着技术的发展,目前已逐渐超出类人的概念,例如把对结构的认知抽象、识别和匹配成各种模式的机器思维,利用机器学习和数据分析方法,补充和增强人类的思维能力。作为一项关键的生产力工具,人工智能正加速与各行各业深度融合,推动产业升级。AI技术已从早期的辅助性工具演进为具备自主决策能力的智能体(AI Agent),在自动驾驶、智能家居、安防监控、医疗设备、机器人技术、智慧教育等众多行业中发挥出显著的创新价值和落地成效,成为驱动行业智能化转型的核心动力。

2025年,AI Agent的技术框架与应用范式日趋成熟,推动人工智能从工具型辅助向自主任务执行与决策协作演进。大模型技术持续突破,其核心进展体现在对复杂指令的理解、多步骤规划以及跨模态任务的统一处理能力上,为代码生成、个性化教育等高价值场景提供了可靠支撑。开源生态的繁荣加速了技术普惠,使高性能模型得以用更低的成本在更广泛的行业落地。同时,多模态大模型深度融合文本、图像、语音与视频理解,不仅在创意内容生成、智能交互加手等领域提升了体验,更通过轻量化技术在教育、医疗、工业质检等垂直领域实现了即插即用的部署,彰显了AI赋能实体经济,提升运营效率的巨大潜力。

随着用户对响应速度、使用成本和安全隐私及个性化的需求增强,通过端侧算力的性能增强和大模型算法的裁剪优化,大模型相关应用正在迅速往端侧迁移并进行适配,形成云、边、端的多层次应用架构。以AI手机和AI PC为代表的端侧产品形态,目前已催生了众多新兴的硬件产品和多样化的软件应用。随着相关技术的迭代创新,端侧AI的发展将覆盖从行业设备到消费电子产品的各类形态中,这为硬件、芯片和软件解决方案带来了新的需求和技术革新的挑战。

对于端侧AI的产品落地,必须具备三个要素:算力、算法、数据。近年来的AI蓬勃发展,主要是得益于大数据的积累以及AI专用算力的大幅增强。随着端侧AI和大模型的规模化落地进程加速,对终端硬件在算力性能、异构协同与能效管理等方面提出了更高的要求。海外领先企业正加速将大模型深度集成至其操作系统、核心应用及硬件生态中,致力于构建云端协同的完整体验闭环。这一趋势为上游芯片设计产业带来了明确且强劲的需求牵引,正驱动其在支持新一代轻量化大模型的终端芯片上寻求结构性突破。为满足轻量化大模型对算力、内存带宽及能效的动态平衡需求,提升对复杂模型的高效支持能力,将实时多模态交互等先进应用推向低功耗、高响应的边缘计算场景。与此同时,从开源模型到工具链的生态协同,正持续完善“云端训练-边缘推理”的技术体系,共同构成了驱动AI产业化纵深发展的核心引擎。

(2)高性能计算需求提升

端侧AI场景的快速普及(如智能终端、自动驾驶、IoT设备),使得SoC芯片的算力需求呈现爆发式增长,驱动SoC设计进入“先进制程、算力升级、架构重构、能耗革命”的新阶段。

先进制程和封装工艺:利用先进制程提升SoC算力已成为高性能SoC的选择,3D堆叠,Chip to Chip,Die to Die的芯片互联方式也成为解决工艺高成本和低良率的有效方案。

通用算力和专用算力的持续升级:随着端侧产品应用场景复杂度提升、AI应用场景增多、功能的整合和集成度的提高,用户体验要求变高等需求,对SoC芯片所提供的CPU、GPU、NPU等算力需求大幅提高,大算力、多核心、高频率、超高清和多路编解码,高速多通道DDR都将成为高性能SoC的标配。

异构协同的架构挑战:端侧SoC芯片的计算单元通常包括CPU、GPU、NPU、VPU和DSP等加速单元,在不同的应用场景下,需要这些计算单元实现协同计算和数据共享,SoC的整体系统架构提出了新的挑战;需要持续优化总线带宽和优先级机制、提供多通道高位宽DDR方案、统一内存架构和芯片间的内存一致性管理,动态任务调度算法,多芯片互联技术,为SoC架构升级提供更多的解决方案。

能耗的有效管理与控制:无论是云端训练还是端侧推理,所需要计算规模和系统数量都是空前的,对能源的消耗也在快速增长,SoC的能耗优化策略将从“局部能耗优化”升级到“系统级能效优化”:通过动态电压频率调节(DVFS)技术和AI驱动的负载均衡策略,提升多核利用率,如基于AI驱动的任务调度算法和AI的预测性功耗管理;混合制程设计将成为平衡性能与成本的关键策略,如Chiplet设计和先进的3D封装设计。

(3)工业控制智能化

在全球制造业转型升级的背景下,工业控制智能化正从“自动化”迈向“自主化”。这一变革以新一代信息技术(AI、边缘计算、数字孪生等)与传统工业控制深度融合为特征,推动工业系统向具备感知、决策、执行闭环能力的方向演进,对底层芯片平台提出新的挑战与机遇。

随着国内制造业的高端化、智能化和绿色化转型,当前转型呈现以下特征:

人机协同模式:工业机器人能力提升,人机协作要求芯片具有高实时性与多任务并行处理能力。

AI技术融合:生成式AI、AR/VR+数字孪生赋能设计、运维、培训等应用场景要求芯片支持边缘AI推理,实现视觉、语音等多模态数据融合。

深度集成系统:智慧工厂对设备互联、数据互通的要求,驱动芯片向异构多核、硬实时、高安全方向发展,并需兼容多种工业总线协议。

硬件算力升级:具身智能机器人等新兴应用对算力需求呈数量级增长,高性能CPU、AI加速单元(NPU)、PCIe、CAN和千兆以太网等工业级高速连接接口成为新一代工业芯片的标配。

(4)汽车智能化

随着国内汽车产业蓬勃发展,为了推动汽车智能化技术本土化发展的目标,国家陆续出台了相关政策支持本土企业研发芯片、操作系统等核心技术,并通过制定国产化技术标准,引导产业链国产化,降低对外依赖,提升产业安全性与竞争力。同时,汽车行业智能化、电动化、网联化快速发展,整车电子电气架构也从传统分布式升级为集中式域控制器架构,这一变革对车规级SoC性能提出更高要求,国内头部车厂牵头硬件、算法和OS全栈整合,从传统座舱域、辅驾域、控制域,独立PCB+车联网通信,演进到“舱泊一体、舱行一体”跨域融合高阶架构。

硬件方面:“先进工艺、高端架构、算力堆叠、总线级联扩展”实现“高性能异构架+AI大算力+功能安全+信息安全+高速带宽&扩展接口”,实现“舱、泊、行”单颗融合。

软件方面:“硬件隔离+硬件虚拟化”跨域融合架构整合,实现座舱多屏交互+AI多模态交互、辅助驾驶感知和决策处理,保证“行、泊”域的功能安全和信息安全。

软硬件实现功能冗余预埋+软件OTA激活,满足整车厂价格配置分档、客户定制付费升级的商业化需求。

除座舱智能化外,车路协同技术也在同步推进,车路协同(V2X)技术作为实现智能交通的关键,正迎来快速发展期。通过车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与人(V2P)之间的信息交互,能够实现交通流量优化、事故预警、智能停车等功能。

基于上述趋势,OEM主机厂和Tier1供应商正在积极布局这些新兴技术路径,以满足不同车型和市场需求。随着制程工艺的提升、SoC芯片等硬件的性能也不断增强,为智能座舱提供了强大的算力支持;同时,集成了更多功能模块的SoC芯片也将进一步增强智能座舱的集成度和性能。

(四)报告期内经营情况

公司坚持在新技术、新芯片、新应用上持续高强度的投入,不断在智能汽车电子、工业控制、消费电子等领域积极拓展新市场、新客户、新应用,公司新产品及新方案顺利量产,推动公司业绩增长。报告期内,公司实现营业收入283,795.39万元,比上年同期增长24.04%,归属上市公司股东的净利润26,213.26万元,比上年同期增长57.20%。

1.用技术创新提升产品竞争力

(1)持续打造高性能通用异构计算平台

随着人工智能技术的迅猛发展,对高算力、异构集成、高带宽及极致能效的需求呈指数级增长,公司致力于构建序列化的通用异构计算平台和产品矩阵,全面推动各领域的智能化升级。

报告期内,公司通过深度优化总线架构、智能调度算法及底层操作系统,成功实现了涵盖CPU、GPU、NPU、DSP及RISC-V协处理器的复杂异构芯片规模化量产,标志着公司已具备提供灵活算力组合策略的能力,能够精准匹配不同应用场景的差异化需求。在ARM架构上,公司已完成多档位高性能处理器布局,包括八核A55、八核A73+A53、八核A76+A55等多档位布局;同时积极探索RISC-V处理器在协处理器和主处理器的应用,构建自主可控的算力底座。在音频处理领域,借助HiFi4、HiFi5等DSP算力补充,充分满足了多样化的音频应用需求。面向未来,公司正积极布局前沿技术,持续攻坚高算力平台,探索100K+ DMIPS CPU算力、512G+ Flops GPU算力及10T+ Flops NPU算力的技术突破,开展Chiplet(芯粒)技术研究,以提升芯片集成度与性能灵活性;推进AI融合的8K超高清编解码及显示技术研发,为超高清多媒体持续赋能;探耕高速互联技术,开展高速率SerDes的研究,为下一代高性能计算平台奠定坚实基础。

(2)完善AI算法及应用落地

公司继续深耕视觉、语音、显示及人机交互等典型场景,积极储备并适配各类AI算法,拓展其在各细分领域的应用落地;通过推动硬件、软件与算法的协同升级,持续优化场景体验,驱动各领域的进步与创新。

在视觉技术方面,公司持续深化ISP与AI的融合,旨在提升视觉体验、降低能耗并拓宽应用场景。在视觉体验上,新一代AI-ISP针对低照度环境优化算法,在同等信噪比条件下,实现感光度2~4倍的提升,显著改善暗部色彩还原及噪点控制表现。在能效表现上,新一代AI-ISP使内存占用及带宽需求降低近30%~50%。在安防应用场景中,公司不断丰富AI算法库,在既有人脸/人形检测与识别、人形追踪、车辆/包裹/宠物检测等基础算法之上,新增自研的“AI人车宠三合一监测”、“AI婴儿躺床监测”及“AI人车周界防范”等算法;同时,利用AI SR算法对红外成像技术进行定向优化,提升热红外成像画质,以满足社会管理与家庭看护等多样化需求。在拍照摄影场景中,推出了AI ISP智能成像、AI夜景人像、AI超清图像、AI美颜、AI人像虚化、AI抠图及AI魔法换天等功能,显著提升了画质表现与创作自由度。

此外,公司将提速AI视觉在端侧的落地,覆盖摄影摄像、视频通讯、智能车载、机器人感知及工业检测等多元场景,全力推动AI视觉降噪、AI图像检测及AI视觉识别等算法的商用化进程,构建端侧智能新生态。

在超清显示技术方面,公司通过AI与传统算法的深度融合,持续提升显示体验。针对海量互联网片源帧率低而显示设备刷新率高,进而导致播放卡顿、流畅度不足的痛点,公司利用异构算力并行加速实现了AI MEMC(AI 运动补偿)技术,支持任意分辨率与帧率的片源输入,实时智能插帧输出60fps视频,大幅提升观影流畅度。同时,面向云电脑、移动设备及商业显示等场景中低清晰度视频的播放需求,持续优化AI SR超分辨率技术,可实现将480P视频超分至4K分辨率。

(3)升级核心技术完善细分领域产品系列

在通用计算平台的基础上,公司紧扣细分领域客户的痛点,依托统一、高效且高质的技术研发平台,快速迭代芯片产品与解决方案,持续推动各细分领域的核心技术升级与产品矩阵完善。

在智能平板领域,公司完成新一代普惠型智能平板芯片A333的验证,并规模量产,与原有A1X系列、A5X系列和A7X系列平板芯片形成更加完整产品矩阵,并全面通过Google Android 16 GMS Express认证。同时,公司启动新一代A7X系列芯片的升级与迭代工作,旨在进一步提升产品体验和竞争力。

在机器人和工业控制领域,公司发布新一代控制型机器人芯片MR153,并开始在客户项目中进行试量产。该芯片搭载四核ARM处理器与专用RISC-V实时处理器,以及丰富的UART、PWM、GPIO等接口资源,能够更精准地支持红外传感器、陀螺仪、超声波、线激光及ToF等多种传感器接入,提升实时运算与控制性能。目前,公司已在机器人领域完成MR153、MR527、MR536的序列化布局。

在工业控制和人机交互领域,公司发布新一代工业专用控制芯片T153,可用于工业PLC、工业HMI,工业网关及电力应用。该芯片搭载四核ARM处理器与专用RISC-V实时处理器,配备三个千兆以太网口、双CAN-FD接口及LocalBus,支持高吞吐量网络连接,完美契合复杂数据驱动型应用需求。此外,T153提供24路GPADC、6路TWI接口及30路PWM等丰富外设,提升了自动化系统的集成灵活性与扩展性;配套的多核AMP架构软件开发包,则充分满足了工业自动化对高实时性的严苛要求。

在智慧视觉领域,公司完成新一代智慧安防芯片V861验证和试产。V861全面升级了AI-ISP图像处理单元与H.264/H.265编码器,具备4K高清视频处理能力,并支持三路摄像头直连。V861还集成了全自研NPU内核AWNN100,为AI算法的支持和场景的落地提供了更好的支撑。除此之外,公司发布了新一代AI智能眼镜芯片V881,并完成回样进入验证环节,V881在V821智能眼镜芯片基础上升级编码能力到4K30fps,具备2千万拍照能力和更好的图像处理能力,同时升级无线能力到WiFi6来提高传输效率和用户体验。目前,公司已在智能视觉领域形成V821、V831、V851、V861、V881的完整序列化布局,实现了从2M到8M市场的全面覆盖。

在智能解码显示领域,公司完成了第二代智能投影芯片H723系列和面向超微型投影的H135系列的产品发布和规模量产,并完成面向高性能海外视频认证机顶盒芯片H626和智能投影芯片H736的流片和回样。H723定位智能投影芯片,支持8K24fps的解码能力并提供多种显示输出接口;H135定位微型投影芯片,具备1080P视频解码和显示输出能力;H736定位海外视频认证投影芯片,支持AV1硬件解码器,并升级到4核A55 CPU和G310 GPU架构,提升产品性能和用户体验;H723、H736以及H135全系均内置的硬件梯形校正引擎,有效提升了UI刷新率,降低了画面锯齿与输入延迟,改善了投影体验。在智能解码机顶盒领域,公司发布面向海外视频认证及运营商机顶盒芯片H626,采用四核A55 CPU与G310 GPU架构,并支持AV1解码器与新一代安全架构,支持HDMI 2.1输出接口和USB3.1接口,填补了公司海外认证机顶盒市场的空缺。

(4)SoC周边芯片配套,提升方案竞争力

随着公司产品下游应用版图的持续扩张,各类应用场景对配套芯片及整体解决方案的需求日益迫切。为此,公司持续加大研发投入,加速推出高性能配套产品,以构建更具竞争力的“SoC+配套芯片”产品生态。

在无线产品领域,公司成功完成首颗支持2.4G/5.8G双频、80M频宽的WiFi6和双模蓝牙5.3 Combo芯片的投片与验证工作,并进入客户试产阶段。

在电源管理与电量监测领域,支持PD 3.0协议的快充芯片AXP517与高精度电量计芯片AXP2602已实现大规模量产,同时为安防领域产品推出专用电源管理芯片AXP333并进入推广阶段。

2.深耕应用市场,完善产业布局

报告期内,公司在主要应用市场业务开展情况如下:

(1)机器人与工业控制

随着人工智能技术的持续发展,人工智能技术也在助力推动工业智能化升级和机器人智能化升级,而感知力、认知力、控制力升级成为未来产品发展的主要方向。

在机器人领域,公司AI机器人芯片MR536,已成功导入多家行业头部客户及核心方案商。基于该芯片打造的多款扫地机器人产品、割草机器人等机器人产品,凭借融合感知、视觉避障、高精度地图定位及混合清洁力等卓越性能相继上市并实现大规模出货。同时,依托新一代控制型机器人芯片MR153,公司与多家头部客户联合开发了入门级服务机器人产品及专用控制模块,目前相关产品已顺利量产,进一步丰富了公司在机器人领域的产品梯队。

在工业控制领域,公司推动高性能芯片T536和控制型芯片T153在行业头部客户中的落地应用,相关产品形态涵盖电力设备、PLC、工业网关、3D打印机、工业HMI及工业边缘计算设备等多元化场景。目前,搭载T536和T153的工业开发板均已上市销售。凭借卓越的性能表现、高可靠性及广泛的场景适应性,T536在中国工控网主办的“中国自动化+数字化产业年会”中荣获“工业芯新质奖”,充分体现了公司在智慧工业领域技术实力和产品创新能力。同时,公司积极拥抱工业开源生态,参与开源社区活动,适配国产开源鸿蒙操作系统,并获得了开放原子开源基金会授予的生态产品兼容证书。在第25届中国国际工业博览会上,T536斩获工博会“集成电路创新成果奖”。

(2)发挥算力及性价比,布局车载驾舱

智能汽车电子市场,公司全面深化与主流车企的合作,重点推动基于T527V平台的前装定点项目方案落地,巩固了现有合作成果的同时,成功拓展了多家新客户及多个新项目。面向更高性能需求的T736智能座舱方案已开始交付,并正与多家头部车企开展新一轮定点项目的洽谈。

公司将持续围绕这两个平台,推动芯片方案在前装智能驾舱领域的量产。截至目前,通过积极和国内头部车企开展研发合作,公司已积累了智能座舱、全数字仪表、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等多种智能模块解决方案。随着大模型技术的逐步成熟,未来公司将积极探索大模型在车载智能化应用的机会,并投入研发相关技术和产品,把握全车智能化的产业机遇,为全车智能化的进程助力。

(3)围绕平台芯片,深耕平板及行业应用

通用智能终端市场,安卓生态的持续演进已成为驱动行业发展的核心引擎。

一方面,公司持续完善高性能智能终端芯片的产品矩阵,不断拓展应用版图。报告期内,搭载八核A73+A53处理器的A537芯片已率先在智能平板市场实现大规模量产;凭借其在性能与功耗平衡上的卓越表现,该芯片在中端市场赢得了良好的市场反响,并进一步延伸至智能教育、智能家居等领域。同时,搭载八核A76+A55处理器的A733芯片,在稳固智能平板大规模量产的基础上,积极与核心客户联合开发教育平板、商显设备、收银终端及云电脑等应用场景;目前,相关产品已正式量产并处于稳步爬坡阶段。

另一方面,公司深度整合AI技术,积极推动智能终端向“+AI”方向迭代升级,以满足各行业从传统计算向智能计算跨越的需求。公司紧密联动生态合作伙伴,依托A733强大的CPU+GPU+NPU异构算力,在智能平板、教育平板等应用中,积极开发并适配了AI超分、AI画质增强、智能语音交互、AI辅助学习等AI技术,成功量产了多款具备差异化竞争力的“+AI”型产品,显著提升了用户体验与产品附加值。未来,公司将持续推动传统智能终端向具备主动感知、深度学习及智能决策能力的AI型智能终端升级。

(4)解码与家庭娱乐

智能机顶盒市场,受益于海外视频播放需求的增长,公司H313和H618系列产品凭借其优异的多媒体播放能力和兼容性,获得良好市场反应。搭载了2T NPU的八核智能媒体处理器H728已实现大规模量产,进一步丰富了高端产品线。面向海外高清内容认证的第三代机顶盒芯片H626也顺利完成流片并回样,为拓展全球市场奠定了坚实基础。

智能投影市场,随着单片LCD投影光机技术的日益成熟,家用投影机的销量持续快速增长。报告期内,公司推出了超微型投影芯片H13X系列与第二代智能投影芯片H72X系列。凭借优秀的画质表现及公司自研的硬件梯形矫正引擎,获得了客户的认可,实现大规模量产,成为智能投影市场主流方案。此外,支持海外内容认证的第三代智能投影芯片H736也已完成流片及回样验证,将助力公司进一步扩大在智能投影领域的影响力。

智能电视市场,第一代TV303芯片成功量产后,为满足智能电视市场的升级需求,公司已完成了第二代智能电视芯片TV323的样品验证,并开始向下游客户推广。

(5)智慧视觉与安防应用

智慧视觉与安防市场,报告期内,V821凭借较好的性能和较高的集成度,覆盖数十家安防核心客户,并快速实现了大规模量产和持续增长;同时,由于其完善的方案和产品体验,V821智能眼镜解决方案成为眼镜量产方案中的主流方案,获得了眼镜穿戴市场的青睐和认可,并完成百万级别量产;新产品安防芯片V861和影像芯片V881在性能,画质和功耗方面均全面升级,同时凭借其产品包高度的继承性,客户端也在快速的导入和开发。

针对安防和影像视觉产品和场景,公司在影像降噪技术,防抖和对焦技术,以及图像超分技术上都实现了新的升级和应用落地,加速了市场领域的拓展。在智能穿戴领域,视觉眼镜与穿戴产品,实现百万级量产规模;在智能出行领域,打造多款行车记录仪爆款产品;在智能教育领域,推出系列化AI相机拍学产品;在智能安防领域,构建起覆盖室内至室外的全方位监控产品体系。至此,公司已成功构建“人、车、家”全场景视觉产品布局,形成了覆盖全档位、多领域的丰富视觉产品货架。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,793,678,137.07	3,545,279,812.83	7.01%	3,532,312,526.95
归属于上市公司股东的净资产	3,114,571,880.66	2,993,018,533.79	4.06%	2,962,908,198.69
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,837,953,858.57	2,287,908,816.30	24.04%	1,672,993,031.36
归属于上市公司股东的净利润	262,132,646.57	166,745,799.11	57.20%	22,962,876.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,231,623.33	115,844,231.42	99.61%	7,069,171.73
经营活动产生的现金流量净额	283,595,283.64	196,372,629.14	44.42%	188,348,768.65
基本每股收益(元/股)	0.32	0.2	60.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.2	60.00%	0.03
加权平均净资产收益率	8.65%	5.63%	3.02%	0.78%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	619,857,313.18	717,244,955.93	823,603,075.21	677,248,514.25
归属于上市公司股东的净利润	91,552,036.22	69,612,991.12	117,279,391.82	-16,311,772.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,177,759.77	78,722,106.58	111,143,885.27	-14,812,128.29
经营活动产生的现金流量净额	77,136,367.02	59,626,299.91	135,425,885.25	11,406,731.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	129,654	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	130,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张建辉	境内自然人	8.68%	71,624,006.00	53,718,005.00	不适用	0.00
丁然	境内自然人	7.82%	64,551,343.00	48,413,507.00	不适用	0.00
侯丽荣	境内自然人	7.61%	62,843,131.00	62,843,131.00	不适用	0.00
龚晖	境内自然人	6.35%	52,420,121.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.20%	42,949,674.00	0.00	不适用	0.00
蔡建宇	境内自然人	2.97%	24,542,941.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.37%	11,329,902.00	0.00	不适用	0.00
李龙生	境内自然人	1.12%	9,256,000.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	8,534,788.00	0.00	不适用	0.00
薛巍	境内自然人	0.64%	5,250,160.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系,且不存在一致行动人的情况。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2025年年度报告》。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人:张建辉

2026年3月26日

证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2026-0327-002

珠海全志科技股份有限公司
2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司《2025年年度报告》全文于2026年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-031

海南矿业股份有限公司
关于2025年年度业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“海南矿业”)于2026年3月25日15:30-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)、进门财经(转播,网址:https://s.comein.cn//vae8qh2y)以视频直播和网络互动方式召开了公司2025年年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2026年3月18日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-019)。

2026年3月25日,公司董事长、总裁滕磊先生,职工董事、党委书记刘明东先生,独立董事顾诚先生,副总裁、董事会秘书何婧女士,副总裁、首席财务官朱彤先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会交流概况

公司副总裁、董事会秘书何婧女士主持本次业绩说明会。

公司副总裁、首席财务官朱彤先生对公司2025年主要财务指标进行了解读,并对2025年主要财务数据变化和资产、